

中国 3G 产业链获重大进展 鼎芯打通 TD 电话

[2006-04-10]

鼎芯通讯(Comlent), 设在上海浦东的中国第一家专业射频集成电路芯片设计企业, 今天宣布: 其射频芯片已经成功在 TD-SCDMA 网络上实现通话。这是第一颗由中国企业完全自主设计并实现通话的 TD-SCDMA 射频集成电路(RFIC)芯片, 也极可能是全球第一个支持 TD-SCDMA 的、集收发于一体的单芯片射频方案。该芯片的成功通话, 标志着中国在建设自主倡导的 TD-SCDMA 国际标准 3G 产业链, 尤其是在未来终端领域自主创新及掌握关键核心技术方面取得重大突破, 实现了从射频集成电路(RFIC)到基带集成电路(BBIC)的完整解决方案。

中国作为世界第一大移动终端产品市场, 目前已拥有 4 亿手机订户, 并且每年新增手机用户超过 5000 万。中国的 3G 网络特别是中国自主创新并主导的 TD-SCDMA 国际标准预计将于 2006 年起跑; 2007 年 TD-SCDMA 终端用户量将达到数百万。相对于由美国和欧洲分别主导的 CDMA2000 和 WCDMA 标准, TD-SCDMA 3G 标准由于中国核心芯片产业的相对薄弱致使终端设计受到较大限制, 产业化之路面临挑战。TD-SCDMA 终端依赖的基带和射频两大类核心芯片中, 前者已经有凯明和展讯等五家中国企业(包括在中国的中外合资企业)可以提供; 而射频芯片至今仍然依赖两家美国公司的样片, 不利于 TD-SCDMA 产业链的快速发展。鼎芯作为国家信息产业部、科技部和发改委联合成立的“TD-SCDMA 国家专项基金”选择并大力扶持的专业射频芯片企业, 在 TD-SCDMA 射频芯片的研发方面投入了大量人力物力, 终于率先成功实现其射频芯片的 TD-SCDMA 网络通话, 这一新突破将为整个中国 3G 产业的起飞提供助力。

“作为中国最早建立并率先实现产业化的射频芯片设计企业, 鼎芯的商业策略就是为中国本土市场提供原来一直欠缺的世界级射频和混合信号芯片设计方案”, 公司总裁兼 CEO 陈凯博士表示, “鼎芯将继续发挥多赢的产业联盟与合作伙伴关系的力量, 与凯明等 TD-SCDMA 基带芯片厂商紧密合作, 在捷智半导体等 FOUNDRY 厂商的大力支持下, 以完全整合的产业链来支持中国 3G 手机设计厂商”。

“凯明很高兴看到中国本土企业自主开发的 TD-SCDMA 射频芯片取得的重大进展, 尤其是鼎芯采用目前国际上最先进的零中频(zero-IF)射频芯片设计技术, 并成功实现单芯片收发, 达到了 TD-SCDMA 射频芯片领域的世界先进水平。”凯明信息科技股份有限公司 CEO 余玉书说, “本土基带和射频芯片的紧密配合将帮助中国手机厂商打造其核心竞争优势, 从而更好地服务并赢得市场”。

“捷智半导体很高兴能作为鼎芯的 FOUNDRY 合作伙伴为其提供支持。射频集成电路(RFIC)收发器芯片的设计难度之高已为全球芯片设计业界所公认。而鼎芯正是在该领域取得快速发展并成功完成初期产品产业化, 成为我们在中国大陆地区第一个百万颗射频芯片客户”, 捷智半导体公司技术与工程副总裁 Marco Racanelli 先生说, “鼎芯如今又在目前世界最具挑战性的 3G 射频芯片领域取得如此重大进展, 证明了中国高端芯片设计产业的潜力。捷智将继续支持鼎芯, 助其实现对新兴的中国无线通讯市场的战略性承诺”。